

Messeführer Guide d'exposition



 productronica

SEMICON[®]
EUROPA

18.-21.11.2025
Messe München

Willkommen zur productronica und SEMICON 2025 **Bienvenue à productronica et à SEMICON 2025**

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, geschätzte Partner und Lieferanten

Wir begrüßen Sie auf den weltweit führenden Leitmesse für Elektronikfertigung und Mikroelektronik. Auch 2025 erwarten Sie wieder technologische Weltpremieren, neueste Produktentwicklungen und zukunftsweisende Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Prototypenfertigung über Serienproduktion bis hin zu Software, Services und Systemintegration.

Die Hilpert electronics AG ist traditionell auch in diesem Jahr Ihr verlässlicher Ansprechpartner vor Ort. Unser Vertriebsteam steht Ihnen an den Messeständen unserer Lieferanten zur Verfügung und präsentiert Ihnen ein umfassendes Portfolio an Technologien, Anlagen und Lösungen für moderne Elektronik- und Halbleiterproduktion.

Im beigefügten Messeführer finden Sie eine alphabetische Übersicht unserer Partner mit Standnummern zur schnellen Orientierung. Gerne können Sie bereits im Vorfeld Termine mit unserem Team auf den jeweiligen Ständen vereinbaren. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch während der Messe jederzeit persönlich für Gespräche und Beratungen zur Verfügung.

Die Kontaktdaten unserer Produktspezialisten finden Sie ebenfalls im Messeführer. Wir nehmen uns vor Ort gerne Zeit für Ihre Fragen und spezifischen Anforderungen.

Wir wünschen Ihnen einen informativen und erfolgreichen Besuch der productronica 2025 und SEMICON 2025 in München. Wir freuen uns auf den direkten Austausch mit Ihnen.

Chères visiteuses, chers visiteurs, chers partenaires et fournisseurs

Nous vous souhaitons la bienvenue aux salons leaders mondiaux dédiés à la fabrication électronique et à la microélectronique. En 2025, vous découvrirez à nouveau des premières mondiales technologiques, les toutes dernières innovations produits ainsi que des solutions tournées vers l'avenir couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur – de la fabrication de prototypes à la production en série, jusqu'aux logiciels, services et intégrations de systèmes.

Hilpert electronics AG sera, comme chaque année, votre partenaire de confiance sur place. Notre équipe commerciale sera présente sur les stands de nos fournisseurs pour vous présenter un portefeuille complet de technologies, d'équipements et de solutions destinées à la production électronique et semi-conducteurs moderne.

Dans le guide du salon joint, vous trouverez un répertoire alphabétique de nos partenaires ainsi que leurs numéros de stand pour vous orienter rapidement. Vous pouvez également convenir à l'avance de rendez-vous avec notre équipe sur les différents stands. Bien entendu, nous restons également à votre disposition pour des échanges spontanés et des conseils personnalisés tout au long du salon.

Les coordonnées de nos spécialistes produits figurent également dans le guide. Nous serons ravis de prendre le temps de répondre à vos questions et à vos besoins spécifiques directement sur place.

Nous vous souhaitons une visite riche en informations et couronnée de succès à productronica 2025 et à SEMICON 2025 à Munich. Nous nous réjouissons d'échanger directement avec vous.



Raphael B. Burkart
CEO | DG

raphael.burkart@hilpert.ch
+41 56 483 25 01
+41 79 654 22 22

Die Hilpert electronics-Produktexperten Les expertes des produits Hilpert electronics



Ralf Jentscher

ralf.jentscher@hilpert.ch

+41 56 483 25 47

+41 79 374 75 70



Axel Tschumi

axel.tschumi@hilpert.ch

+41 56 483 25 07

+41 79 263 38 73



Manfred Vogel

manfred.vogel@hilpert.ch

+41 56 483 25 16

+41 79 907 67 58



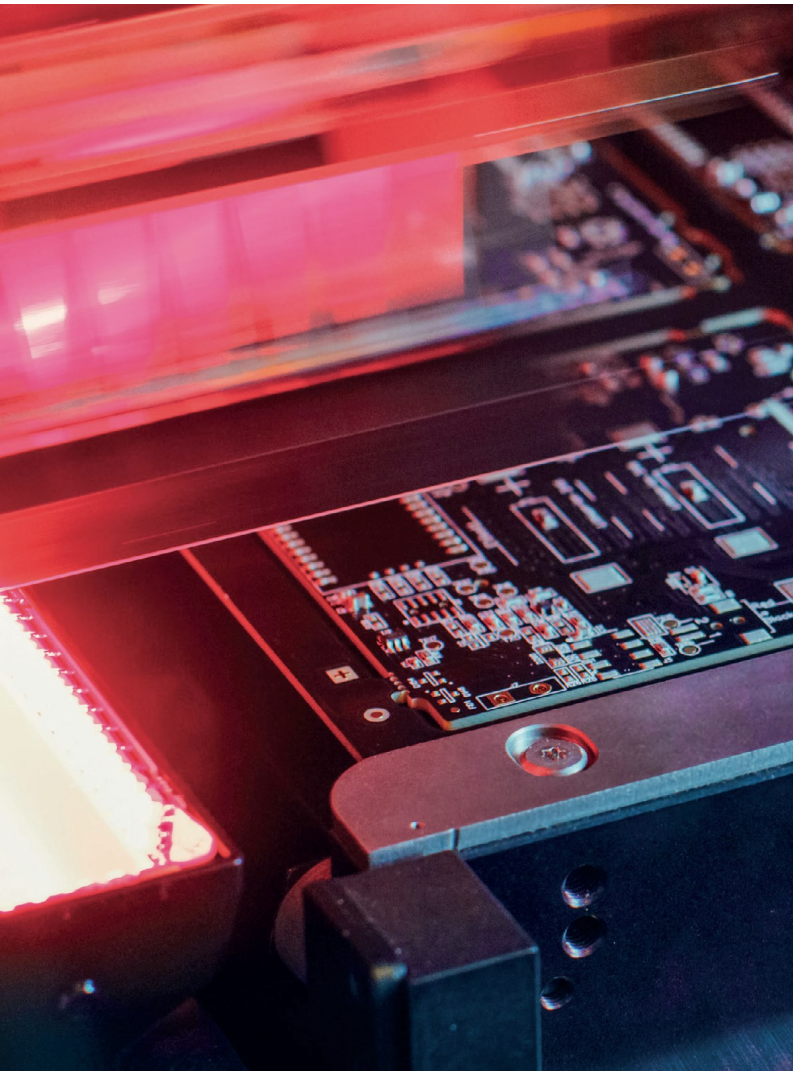
Demian Uehli

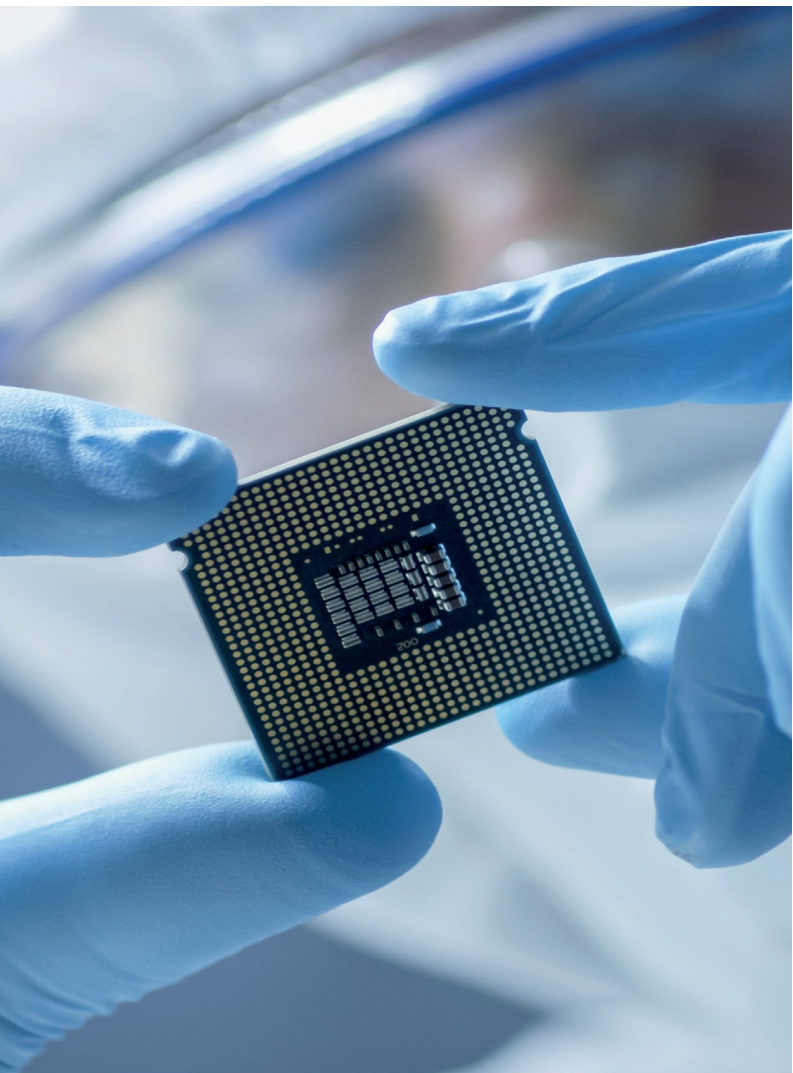
demian.uehli@hilpert.ch

+41 56 483 25 02

+41 79 203 29 23

Hilpert
electronics





www.hilpert.ch

www.hilpert-electronics.de

ASMPT

enabling the digital world

Stand: A3.377

**ASMPT Printing Solutions
(DEK)**

Axel Tschumi

ASMPT

enabling the digital world

Stand: A3.377

**ASMPT Inspection
Solutions**

Axel Tschumi

ASMPT

enabling the digital world

Stand: A3.377

**ASMPT Placement
Solutions (SIPLACE)**

Axel Tschumi

ASMPT

enabling the digital world

Stand: A3.377

**ASMPT Storage
Solutions**

ASMPT

enabling the digital world

Stand: A3.377

**ASMPT Software
Solutions**

ASMPT

enabling the digital world

Stand: A3.377

**ASMPT Process Support
Products**

- Schablonendrucker
- Spannrahmen
- Leiterplattenunterstützung
- Zubehör

- Sérigraphieuses pour pochoir
- Support de cartes auto conformant
- Accessoires



- 5D SPI
- Process Lens HD
- Process Expert

- 5D SPI
- Process Lens HD
- Process Expert



- SMD Bestückungsautomaten
- Automatisierungssoftware / Industrie 4.0

- Machine de placement automatique de composants SMD



- Material Tower—das flexible Lagersystem für die intelligente Fertigung

- Material Tower – le système de stockage flexible pour la production intelligente



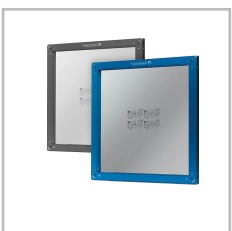
- Works Software Suite
- Factory Solutions
- Critical Manufacturing MES

- Works Software Suite
- Factory Solutions
- Critical Manufacturing MES



- DEK Schablonen
- Rahmen
- Verbrauchsmaterial

- DEK stencils
- Cadres
- Consommables





as-equipment

Raphael B. Burkart



AVIO Nippon Avionics

Raphael B. Burkart



CAB

Demian Uehli



Comet Yxlon

Demian Uehli



Critical manufacturing

Axel Tschumi

Raphael B. Burkart

Stand: A3.377



Deweyl

Manfred Vogel

- Lotpastenmischer

- Mélangeur de pâte à braser



- Widerstandsschweissanlagen
- Bügellötgeräte
- Löt-/Schweissköpfe

- Soudage resistive
- Souder en étrier
- Têtes de soudage



- Leiterplatten-Magazine
- Manuelle Nutzentrenner
- Etikettendrucker

- Magasins de cartes
- Séparateurs de cartes manuels
- Imprimantes d'étiquettes



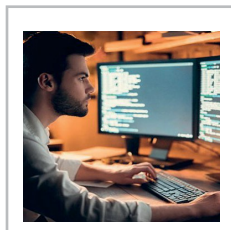
- Mikrofokus-Röntgeninspektion
- Computertomographie

- Inspection par rayons X
- Tomographie par ordinateur



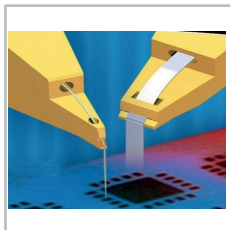
- Manufacturing Execution System (MES)

- Système d'exécution de Fabrication



- Drahtbond-Tools
- Bonding-Keile

- Outils pour Wire Bonding
- Wedges (coins) de câblage par fil





Stand: C1.555

D & X Co. Ltd

Manfred Vogel



Stand: B2.261 und B2.428

F&K Delvotec

Demian Uehli



Stand: B2.438

F&S Bondtec

Demian Uehli



Stand: B1.235

GenISys

Manfred Vogel



Stand: B2.305 und B2.261

LPKF Laser & Electronics

Demian Uehli



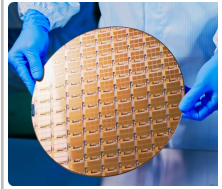
Stand: A4.349

MacDermid Alpha

Raphael Burkart

- Silicon Wafer
- Tape
- Andere Materialien und Produkte
- Priocessing Service

- Wafer de silicium
- Ruban
- Autres matériaux et produits
- Service de traitement



- Automatische Ultraschall und Laser-Drahtbinder
- Pull-Shear-Tester

- Wire Bonders automatiques par ultrasonique et laser
- Pull-Shear-Tester



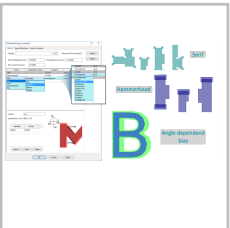
- Manuelle Drahtbinder
- Halbautomatische Drahtbinder

- Wire Bonders manuels
- Wire Bonders semiautomatiques



- Software
- Lithography Simulation
- Inspection and Metrology

- Logiciel
- Simulation de lithographie
- L'inspection et la métrologie



- Leiterplatte strukturieren
- Leiterplatten bohren
- Verfahren zur Durchkontaktierung
- Leiterplatten trennen
- Multilayer-Herstellung
- Lötstoplack auftragen
- Mikromaterialbearbeitung

- Structuration CI
- Perçage CI
- Métallisation traversante
- Découpe CI
- Fabrication multicouche
- ernes épargne
- Microusinage



- Lotpasten
- Lötendraht
- Barrenlot
- Flussmittel
- Lot-Preforms

- Pâte à souder
- Fil à souder
- Barrenlot
- Barres à souder
- Lot-Preforms





MODi

Axel Tschumi

Stand: A2.568



**M-O-T Mikro- und
Oberflächentechnik**

Manfred Vogel

Stand: C1.360

MP DRY CABINET

MP Dry Cabinet

Raphael B. Burkart

Stand: A2.526

MPI CORPORATION

MPI

Axel Tschumi

Stand: C1.537



Namics

Raphael B. Burkart

Stand: B2.432



Nano Dimension

Raphael B. Burkart

- Wareneingangsscanner
- Relabelingsysteme

- Poste de réétiquetage



- Wafer Plating μ GALV-W
- Wet Bench μ CHEM
- Porous Silicon μ PorSi
- tch Stop μ ECES
- Spin Rinse Dryer μ SRD
- Panel Plating μ GALV-P

- Wafer Plating μ GALV-W
- Wet Bench μ CHEM
- Porous Silicon μ PorSi
- tch Stop μ ECES
- Spin Rinse Dryer μ SRD
- Panel Plating μ GALV-P



- Trockenschränke

- Armoires de séchage



- Automatische Waferprober
- Chucks und Micropositioner

- Probers automatiques
- Chucks et Micropositioners



- Die Attach
- Glob-Top
- Underfill

- Die-Attach
- Glob-Top
- Underfill



- Additive Manufacturing Electronics Technology

- Technologie de fabrication additive de l'électronique





Stand: A2.540

Nordson Test & Inspection

Demian Uehli



Stand: A2.477

Nutek

Demian Uehli



Stand: A2.435

OMRON

Demian Uehli



Stand: A3.404

Otto Künnecke

Raphael B. Burkart



Stand: C1.531

PVA TePla

Manfred Vogel



THERMAL SYSTEMS
Stand: A4.335

Rehm Thermal Systems

Raphael B. Burkart

- Röntgen Bauteile-zähler

- Compteur de composants par rayons X



- Leiterplatten-handling
- Laser-Beschrifter

- Convoyage & stockage de carte
- Marquage Laser



- SPI (Solder Paste Inspection)
- Automated Optical inspection (AOI)
- Automated X-Ray Inspection (AXI)
- Instrument zur Prozessverbesserung
- 3D-Kontrollstation

- Inspection de pâte à braser (SPI)
- Inspection optique automatisée (AOI)
- Inspection automatisée par rayons X (AXI)
- Instrument d'amélioration de processus



- Ganzheitliche Lagerkonzepte (Magic Tower)

- Concepts de stockage globaux (Magic Tower)



- Plasmasysteme für Oberflächenaktivierung und Plasma-reinigung

- Nettoyage par plasma
- Traitement de surface par plasma



- Reflowlötanlagen
- Dampfphasenlötanlagen
- Kontaktlötten
- Trocknen und Aushärten
- Coating

- Four de refusion
- Machine à souder en phase vapeur
- Soudage par Contact
- Protection de L'électronique





Temperature Profiling Systems

Stand: A4.220

Solderstar
Raphael B. Burkart



Stand: B1.600

SUSS MicroTec
Manfred Vogel



Stand: A3.155

Systronic
Raphael B. Burkart



Stand: B1.645

**SET-Smart Equipment
Technology**
Manfred Vogel



Stand: A4.125

Topline
Raphael B. Burkart

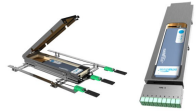


Stand: A1.432

6TL Engineering
Raphael B. Burkart

- Temperatur Mess-Systeme für Industrieöfen

- Systèmes de mesure de température pour fours industriels



- Belacker/Coater
- Mask Aligner
- Waferbonder

- Spin coating
- Aligneurs de masque
- Bonder pour wafers



- Schablonenreinigungsanlagen
- Leiterplattenreinigungsanlagen
- Baugruppenreinigungsanlagen

- Nettoyage des cartes électroniques et des pochoirs



- Flip-Chip Bonder
- Device Bonder
- NIL

- Soudage de puce et FlipChip
- Device Bonder
- Nanoimprint Lithography



- Dummy-Komponenten

- Composants factices pour tests



- Modulare Testsysteme für Elektronikproduktion
- In-line und Off-line Testplattformen
- Flashing- und Prüfstationen
- Schalt- und Multiplex-Module

- Systèmes de test modulaires pour la production électronique
- Plateformes de test en ligne et hors ligne
- Stations de flashage et de test
- Modules de commutation et multiplexeurs



Stand: C1.554



Vliesstoff Kasper
Raphael B. Burkart

Stand: A3.300



Finanzierungslösungen von
Einzelmaschinen und gesamten
Fertigungslinien

Solutions de financement
pour des machines
individuelles et des lignes de
production entières

- Laboröfen
- Hot Plates

- Fours de refusion
- Hot Plates



- Trockene Reinigungstücher
- Feuchte Reinigungstücher
- Reinigungsrollen

- Lingettes de nettoyage
- Rouleaux de nettoyage



Im Rahmen unserer Dienstleistungen bieten wir unseren Kunden ein individuelles Leasingprodukt an, zugeschnitten auf die Schweizer Elektronikfertigungs- und Halbleiterbranche sowie für die



Dans le cadre de nos services, nous proposons à nos clients un service de location individuel, adapté à l'industrie suisse de la fabrication et de l'automatisation de l'électronique.
www.hilpert.ch/dienstleistungen/

Geländeplan 2025: Guide d'exposition 2025:



Halle A1

6TL Engineering	A1.432
-----------------	--------

Halle A2

Comet Yxlon	A2.351	Nordson	A2.540
MODI	A2.568	Test&Inspection	
MP Dry Cabinet	A2.526	Nutek	A2.477
		OMRON	A2.435

Halle A3

ASMPT Printing Solutions (DEK)	A3.377	ASMPT Software Solutions	A3.377
ASMPT Inspection Solutions	A3.377	CAB	A3.305
ASMPT Placement Solutions (SIPLACE)	A3.377	Critical Manufacturing	A3.377
ASMPT Storage Solutions	A3.377	Otto Künnecke	A3.404
ASMPT Process Support Products	A3.377	Systronic	A3.155
		Vliesstoff Kasper	A3.300

Halle A4

Rehm Thermal Systems	A4.335	Topline	A4.125
Solderstar	A4.220	MacDermid Alpha	A4.349

Halle B1

SUSS MicroTec	B1.600	GeniSys	B1.235
SET – Smart Equipment Technology	B1.645		

Halle B2

F&K Delvotec	B2.261 / B2.428	LPKF Laser & Electronics	B2.305 / B2.261
F&S Bondtec	B2.438	NAMICS	B2.432

Halle C1

D & X Co. Ltd	C1.555	MPI Corporation	C1.537
M-O-T Mikro- und Oberflächentechnik	C1.360	PVA TePla	C1.531
		Unitemp	C1.554

Termine & Notizen:
Rendez-vous & note:

Termine & Notizen:
Rendez-vous & note:

Hilpert electronics ist Ihr zuverlässiger Partner für die komplette Produktionsausstattung in der Elektronikentwicklung und -fertigung, Mikroelektronik sowie Mikromechanik als auch für alle dazu notwendigen Verbrauchsmaterialien.

Sie erhalten bei uns alle Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlagen - angefangen bei der kompetenten Prozess- und Applikationsberatung über die Lieferung und Systemintegration bis hin zu maschinenspezifischen Trainings sowie Wartungs- und Reparaturdienstleistungen.

Hilpert electronics est votre partenaire de confiance pour l'ensemble des équipements de production de la fabrication électronique et de son développement, de la microélectronique et de la micromécanique ainsi que pour tous les consommables associés à ces domaines.

Nous vous fournissons tous les services d'accompagnement tout au long du cycle de vie de vos installations. En commençant par l'apport de nos compétences en matière de processus et d'applications jusqu'à la livraison et l'intégration des systèmes, sans oublier les formations spécifiques à l'utilisation des machines, la maintenance et les réparations .

Hilpert electronics AG
Täferstrasse 29
CH-5405 Baden-Dättwil

Telefon +41 56 483 25 25
Telefax +41 56 483 25 20
office@hilpert.ch
www.hilpert.ch

